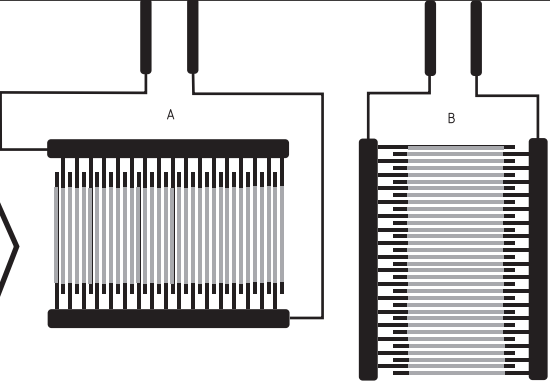
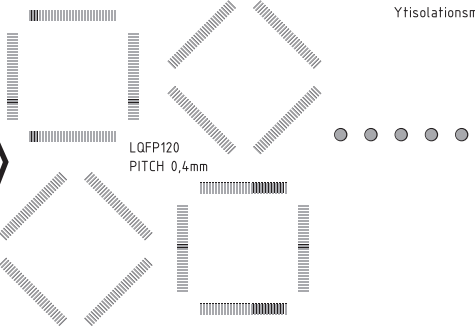


Ytisolations mätning.
Med tryckt- och omsmält lodpasta mäts ledningsförmågan i olika mycket luftfuktighet och temperatur.

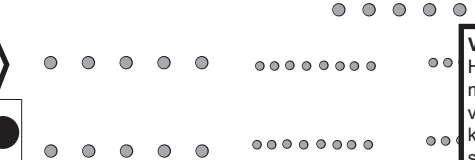


Ytisolationsmätning, SIR

Fine pitch test
Test av tryckning på små öppningar i olika riktningar avslöjar hur väl pasta fungerar ihop med tryckare och plåt.



Pin-in-paste
Att trycka i genomplätterade hål indikerar vätkraften hos pastan.



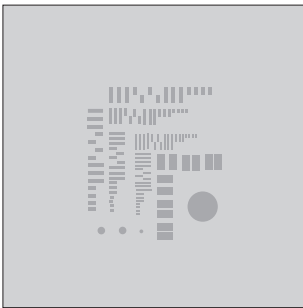
Vättnings test
Här ges möjlighet att mäta hur långt pastan väter ut. Med denna test kan man också fila på som ungs profil.

Paste release test:
Här testas pastans förmåga att släppa från plåten, eller snarare plåtens förmåga att släppa pastan. Minsta pitch är 0,3mm (12 mil)

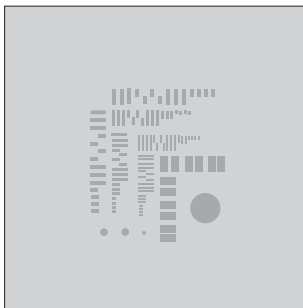
Slumping test:
Efter förvärmning kan man se om pastan står prydligt kvar eller den har säckat ihop.



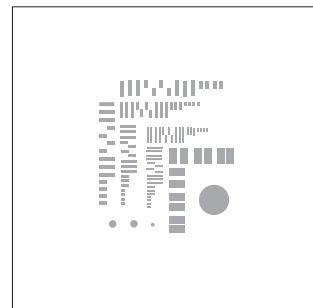
Lödstopplack och jordplan.



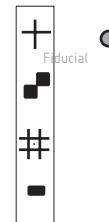
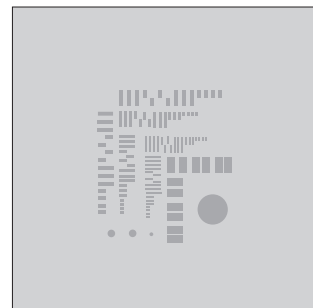
Ren koppar



Lödstopplack utan jordplan.

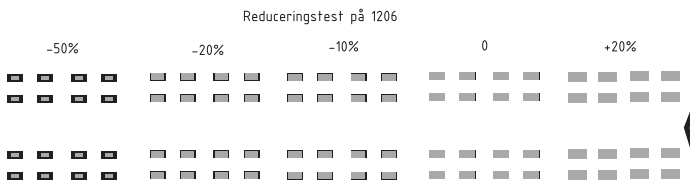


Ren FR4



Kombinationstest av slumping och lodkule bildning.
Om en pasta slumpar kommer mönstret att smälta ihop efter omsmältning. Dessutom kan man se i flussresternas yttre kant om det finns små lodkuler kvar. På de viset kan man se pastans förmåga väta, samt att bilda lodkuler. Testet sker under två olika förutsättningar med och utan jordplan, på lödstopplack.

Flussrest test
På ren FR 4 är det mycket avslöjande hur mycket flussmedels resterna breder ut sig. Med denna test kan man justera sin profil så att man får flussresterna dit man vill.



Test av reducering på stencilöppningar.
Från 50%, 20% & 10% reducering, till 1:1 öppning. Dessutom en öppning med 20% övertryck. Där kan man se förmågan till kul bildning.